



平成 27 年 11 月 30 日

各 位

会 社 名 アプリックス IP ホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役 兼 取締役社長 郡 山 龍  
(コード：3727、東証マザーズ)  
問合せ先 取 締 役 長 橋 賢 吾  
(TEL. 050-3786-1715)

## 世界初<sup>※1</sup>の家電機器向け IoT 用アナログ半導体を開発 ～ ジェネリック家電を 1 チップで IoT 製品化 ～

当社は、家電機器を Internet of Things (以下「IoT」) 製品にするために必要となるアナログインタフェースを 1 チップにした IoT 用アナログ半導体を世界で初めて開発したことを発表いたします。

### 記

#### 1. 概要

生活家電や調理家電等の一般的な家電機器は、AV 機器等と違い、サーモスタット、水切れセンサー、ヒーターやモーター等のアナログ電子部品で作られており、スマートフォン等のデジタル機器やインターネット等のデジタル通信網につながりには、個々の製品が使っているそれぞれのアナログ電子部品に合わせた変換回路を開発する必要がありました。

当社では、平成 22 年以来、様々な家電機器や家庭用品をインターネットにつなげるための無線モジュールを独自に設計開発し、製造販売しております。既に 100 社以上の家電機器メーカーや家庭用品メーカーにご利用いただいておりますが、お客様の製品をインターネットにつなげるために、個々の製品が使っているそれぞれのアナログ電子部品に合わせた変換回路を都度設計・開発する必要がありました。

当社では、様々なアナログ電子部品の種類に合わせた変換回路の設計開発をほぼ網羅的に経験できたことにより、一般的な家電機器で使われているアナログ電子回路をほとんど全て変換できる回路を設計することが可能となり、今回の家電機器向け IoT 用アナログ半導体を実現することができました。

また当社では、IoT 用アナログ半導体ともに CPU 等を含めたデジタル半導体も開発しており、Bluetooth 等の無線通信用のモジュールと合わせて、1 チップでジェネリック家電を IoT 化する半導体として家電機器メーカーや家庭用品メーカーに提供するとともに、既に IoT 用のデジタル半導体を発売している大手半導体メーカーや半導体の受託生産を行っているファウンドリ<sup>※2</sup>等にもライブラリーとしてライセンス提供していく予定です。

当社では、平成 16 年から基礎的な研究開発を行ってきた家電機器や家庭用品向けの M2M の技術の経験実績及びノウハウを蓄積してまいりました。それらの集大成である今回の IoT 用アナログ半導体が、平成 32 年には年間出荷台数が 7 億台<sup>※3</sup>に達すると見込まれている IoT 家電機器の起爆剤となり、今後の収益の柱となる IoT 事業の圧倒的な競争優位性を確固たるものにする根幹的な技術になっていくと考えております。

本件に関する詳細につきましては、下記 URL をご参照ください。

<http://www.aplix-ip.com>

※1 家電機器向けの IoT 用アナログ半導体として。平成 27 年 11 月現在、当社調べ。

※2 半導体チップの製造を専門に行う企業。

※3 米国の市場調査会社 IHS により平成 27 年 7 月に公表された予測。

#### 2. 今後の見通し

本件が当社業績に与える影響については未定ですが、大きな影響を与えると判明した場合には速やかにお知らせいたします。

以上